

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于公司原实际控制人违规担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 近日，深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）收到了上海市闵行区人民法院送达的开庭传票。根据民事起诉状，公司原实际控制人及时任董事长侯海良与公司（曾用名：上海至正道化高分子材料股份有限公司）、原告潘征鹏于2020年4月11日签订了《还款及担保三方协议》，公司为该合同项下借款提供连带责任保证。侯海良仅履行了部分还款义务，剩余部分未归还。原告将侯海良、公司诉至上海市闵行区人民法院，诉讼请求偿还剩余借款本金793.87万元及利息160万元人民币，并支付相关诉讼费用。

● 经查询公司档案，公司档案中既没有案件所提及的《还款及担保三方协议》原件或复印件，也没有涉及上述借款担保事项公司用印记录。经查询公司董事会、监事会及股东大会会议存档资料，也未曾审议过涉及上述担保案件所提及的相关议案。上述事项未经公司内部审批手续、未经董事会、监事会和股东大会审议，系在原实际控制人侯海良控制时期、第二届董事会治理下，以公司名义进行的违规担保。

● 截至目前，侯海良已与原告经友好协商自愿达成和解协议，并已支付和解款项，双方之间债权债务已终结，原告已向上海市闵行区人民法院递交撤诉申请。

● 公司对原告的违规担保情形已经消除。公司在本次案件中无需承担责任，预计对公司财务状况及经营成果没有影响。公司将持续关注案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海市闵行区人民法院送达的民事起诉状、传票及应诉通知书（【2024】沪 0112 民初 46514 号），现将有关情况公告如下：

一、本次诉讼的基本情况

近日，公司收到上海市闵行区人民法院出具的民事起诉状及应诉材料获悉，2020年4月11日，公司原实际控制人及时任董事长侯海良，与公司、原告三方签署《还款及担保三方协议》，约定借款总额为1,670.37万元，由公司向原告承担不可撤销无限连带担保责任。此后，侯海良仅履行了部分还款义务，剩余部分未归还。近日，原告将侯海良、公司诉至上海市闵行区人民法院，诉讼请求偿还剩余借款本金793.87万元及利息160万元人民币，并支付相关诉讼费用。

截至目前，侯海良已与原告经友好协商自愿达成和解协议，并已支付和解款项，双方之间债权债务已终结，原告已向上海市闵行区人民法院递交撤诉申请。

二、相关情况说明

公司收到该案件后，立即组织开展自查。经查询公司档案，公司档案中既没有案件所提及的《还款及担保三方协议》原件或复印件，也没有涉及上述借款担保事项公司用印记录。经查询公司董事会、监事会及股东大会会议存档资料，也未曾审议过涉及上述担保案件所提及的相关议案。上述事项未经公司内部审批手续、未经董事会、监事会和股东大会审议，系在原实际控制人侯海良控制时期、第二届董事会治理下，以公司名义进行的违规担保。

三、后续处理措施

1、全面加强内控

公司董事会对上述涉嫌违规事项高度重视，立即组织进行专项讨论，结合《公司法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，对内控制度执行情况进行有效梳理和宣导，加强用印管理，进一步规范用印审批、使用及归档流程，防范此类事件的再次发生。

2、问询时任相关方

公司收到法院相关案件材料时，立即函告原实际控制人及时任董事长侯海良，要求提供上述违规担保事项的完整原始资料，尽快核实该违规担保事项涉及信息，

是否尚存在其他涉及公司的未披露的违规担保事项，以及后续妥善解决方案。截至本公告披露日，已收到当事方的回复如下：

“本人侯海良已与原告达成和解，并已支付了和解款项，双方之间的债权债务已经全部结清，原告已向上海市闵行区人民法院递交了撤诉申请，本人已主动消除损害。除本次诉讼涉及的相关情形外，本人不存在其他涉及上市公司的未披露的违规担保等行为，如存在前述情形的，本人承诺承担因此给上市公司及其股东造成的全部损失。”

3、严格履行信息披露义务

根据《上市公司信息披露管理办法》和相关规定，公司将在该事项取得进展或消除影响后，按照法律法规及监管要求及时履行信息披露义务，保护上市公司及全体股东利益。

四、相关风险提示

本次案件债权债务已终结，原告已向上海市闵行区人民法院递交撤诉申请。公司对原告的违规担保情形已经消除。公司在本次案件中无需承担责任，对公司财务状况及经营成果没有影响。公司将持续关注案件的进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

公司于2024年10月24日披露了重大资产重组预案，拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金的方式取得先进封装材料国际有限公司（Advanced Assembly Materials International Limited）99.97%股权并募集配套资金事项。该事项尚处于预案阶段，尚需公司董事会、股东大会审议通过，上海证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册后方可实施。本次交易存在审批，可能被暂停、中止或者取消等风险，后续推进存在重大不确定性。提请投资者注意交易风险，理性决策，审慎投资。

公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会

2024年11月16日